

Edge Protection™

앰코는 MLF®패키지 설계의 내구성 향상을 위해 테스트 및 표면 실장 조립(SMA)과 같은 작업 중 디바이스의 엣지를 보호하는 Edge Protection 기술을 개발했습니다.

Edge Protection Technology Considerations

앰코의 패키지 보호 기술은 핸들링, 테스트 및 제조 공정 작업 중 발생할 수 있는 MLF®의 모서리 파손을 방지합니다.

Advantages

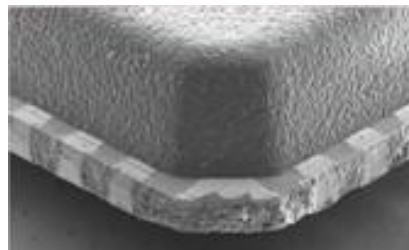
- ▶ 패키지 코너 및 가장자리를 보통보다 2배 이상 강화
- ▶ 테스트로 인한 파손 방지
- ▶ 핸들링으로 인한 파손 방지
- ▶ 패키지 풋프린트는 그대로

바디 사이즈의 이점과 견고한 성능 품질 및 웨더블 플랭크의 집적 등 강점 때문에 양산이 시작되었던 1990년대 후반 이후부터 다수의 자동차 기업들이 앰코의 MicroLeadFrame®패키지를 채택해왔습니다. 앰코는 MLF 패키지를 Punch와 Saw 형식으로 제공하여 자동차 기업 고객들의 까다로운 애플리케이션 요구사항을 충족시키고 있으며, QFN 패키지를 자동차 기업에 공급한 최초의 기업으로 인정받고 있습니다.

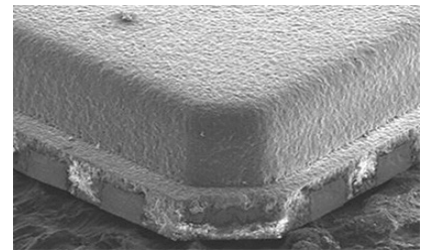
자동차 애플리케이션의 과제를 해결하기 위해 고품질 QFN 패키징 솔루션을 제공하는 유력 업체인 앰코는 MLF 패키징 솔루션의 기능 확장에 매진해왔습니다. 입증된 Dimple end lead 기술을 통한 Punch MLF는 자동차 애플리케이션을 위한 최상의 선택입니다.

앰코의 Edge Protection 기술은 패키지 설계의 내구성 강화 기능을 인정받아 테스트 분야에서 빠르게 적용되고 있습니다. Punch MLF 패키지 모서리의 내구성을 강화함으로써 테스트로 인한 파손이 크게 감소되었습니다.

앰코는 다양한 바디 사이즈의 Edge Protection 기술이 적용된 Punch MLF 패키지를 제공하고 있습니다.



Edge Protection을 적용하지 않았을 때



Edge Protection을 적용했을 때

자세한 내용은 amkor.com을 방문하거나 ATKQnA@amkor.co.kr로 이메일을 보내십시오.



본 문서의 모든 콘텐츠는 저작권법에 따라 무단복제 및 배포를 금지하며, 제공된 정보의 정확성을 보장하지는 않습니다. 앰코는 본 문서의 정보사용에 따른 특허나 라이선스 등과 관련된 어떠한 형태의 피해에 대해서도 책임을 지지 않습니다. 본 문서는 앰코의 제품보증과 관련하여 표준판매약관에 명시된 것 이상으로 확대하거나 변경하지 않습니다. 앰코는 사전고지 없이 수시로 제품 및 제품정보를 변경할 수 있습니다. 앰코의 이름 및 로고는 Amkor Technology, Inc.의 등록상표입니다. 그 외 언급된 모든 상표는 각 해당 회사의 자산입니다.